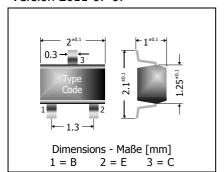


BC846W ... BC849W

Surface Mount General Purpose Si-Epi-Planar Transistors NPN Si-Epi-Planar Universaltransistoren für die Oberflächenmontage

NPN

Version 2011-07-07



Power dissipation – Verlustleistung 200 mW SOT-323 Plastic case Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. $0.01 \, q$

Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Maximum ratings $(T_A = 25^{\circ}C)$

Grenzwerte ($T_A = 25$ °C)

			BC846W	BC847W	BC848W BC849W
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	6 V		5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	200 mW ¹)		
Collector current – Kollektorstrom (dc)		\mathbf{I}_{C}	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	200 mA		
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		\mathbf{I}_{BM}	200 mA		
Peak Emitter current – Emitter-Spitzenstrom		- I _{EM}	200 mA		
unction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$\begin{array}{c} T_j \\ T_S \end{array}$	-55+150°C -55+150°C		

Characteristics ($T_i = 25$ °C)

Kennwerte ($T_i = 25$ °C)

			Min.	Тур.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältr	nis				
$V_{CE}=5~V,~I_{C}=10~\mu A$	Group A Group B Group C	h _{FE} h _{FE} h _{FE}	- - -	90 150 270	- - -
$V_{CE} = 5 \text{ V, } I_C = 2 \text{ mA}$	Group A Group B Group C	h _{FE} h _{FE}	110 200 420	180 290 520	220 450 800
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ²)					
$I_{\text{C}}=10$ mA, $I_{\text{B}}=0.5$ mA $I_{\text{C}}=100$ mA, $I_{\text{B}}=5$ mA		$\begin{matrix} V_{\text{CEsat}} \\ V_{\text{CEsat}} \end{matrix}$	1 1	90 mV 200 mV	250 mV 600 mV

Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Tested with pulses $t_p = 300 \,\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ — Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \,\mu s$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$



Characteristics $(T_j = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

			Min.	Тур.	Max.
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ²)					
$I_{\text{C}}=10$ mA, $I_{\text{B}}=0.5$ mA $I_{\text{C}}=100$ mA, $I_{\text{B}}=5$ mA		$\begin{matrix} V_{\text{BEsat}} \\ V_{\text{BEsat}} \end{matrix}$	_ _	700 mV 900 mV	_
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ²)					
$V_{CE}=5$ V, $I_{C}=2$ mA $V_{CE}=5$ V, $I_{C}=10$ mA		V_{BE}	580 mV –	660 mV –	700 mV 720 mV
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
$V_{CB}=30$ V, (E open) $V_{CE}=30$ V, $T_{\rm j}=125$ °C, (E open)		$\begin{matrix} I_{\text{CBO}} \\ I_{\text{CBO}} \end{matrix}$	_ _	1 1	15 nA 5 μA
Emitter-Base cutoff current					
$V_{EB} = 5 \text{ V, (C open)}$		I_{EBO}	_	-	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE}=5~V,~I_{C}=10~mA,~f=100~MHz$		f⊤	100 MHz	-	_
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$V_{CB}=10~V,~I_{E}=i_{e}=0,~f=1~MHz$		C_{CBO}	_	3.5 pF	6 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität					
$V_{EB} = 0.5 \text{ V, } I_{C} = i_{c} = 0, f = 1 \text{ MHz}$		C_{EBO}	_	9 pF	_
Noise figure – Rauschzahl					
$V_{CE} = 5 \text{ V}, \ I_{C} = 200 \ \mu\text{A}, \ R_{G} = 2 \ k\Omega$ BC846W BC84 f = 1 kHz, $\Delta f = 200 \ \text{Hz}$ BC849W	8W	F F	_ _	2 dB 1.2 dB	10 dB 4 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 620 K/W ¹)		-)
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren			BC856W BC859W		59W
Marking of available current gain groups per type Stempelung der lieferbare Stromverstärkungsgruppen pro Typ BC846A BC847A BC848A	W =	1E B	C846BW = 1 C847BW = 1 C848BW = 1 C849BW = 2	IF BC847 IK BC847	7CW = 1G 8CW = 1L 9CW = 2C

Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% - Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%
 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss